

低温実装で、ボイドの抑制とコストダウンを実現

Realized void-control and cost reduction through low-temperature mounting

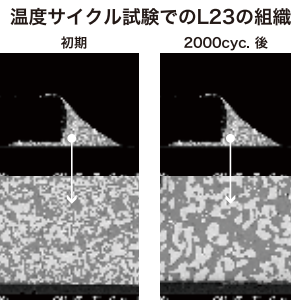
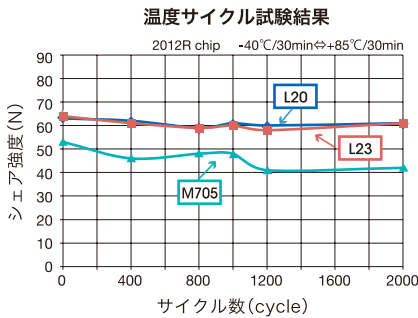
特長

- 低温実装が、省エネ化と部材のコストダウンを実現
- 低温実装が、弱耐熱大型挿入部品のリフロー実装を可能に
- フラックスの改良で、ボイドの発生を抑制

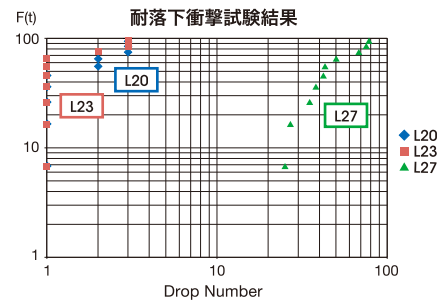


仕様

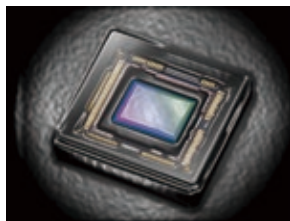
● 耐熱疲労特性に優れるSn-Bi系低融点鉛フリーはんだ



● 耐落下衝撃性を改善した L27 Sn-Bi合金



● リフロー実装を可能とする弱耐熱部品の採用で、コストダウンを実現

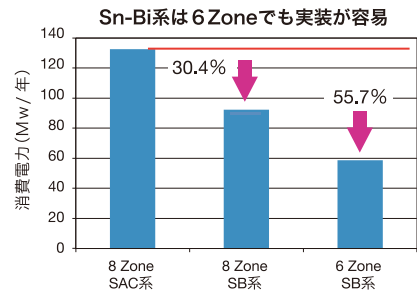


リフロー条件：200°C以下



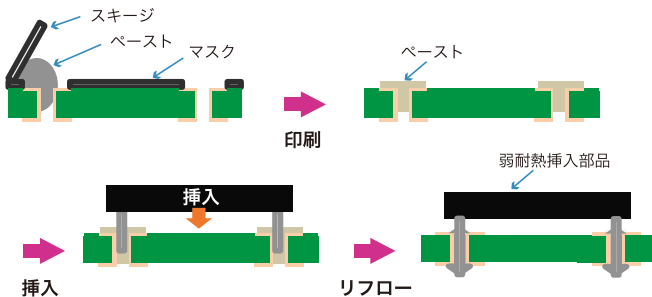
リフロー条件：240°C以下

● 約60%の省エネを実現



● リフロー炉で弱耐熱挿入部品を実装、フロー工程の削除でコストダウン

□ペーストイン スルーホール工法



● フラックスの改良で、はんだボールとボイドの発生を抑制

活性成分の改良で、酸化の激しい Bi 合金のリフロー性を向上させ、ボイドの低減化も実現

